

特点：

- 频率范围：100~500MHz
- 增益：25dB
- 低耗散功率：+5V@75mA
- SMT CQFN20 封装
- 封装尺寸：4×4×1.5mm
- 工作温度：-55~+85℃
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数：(TA=+25℃，50Ω系统)

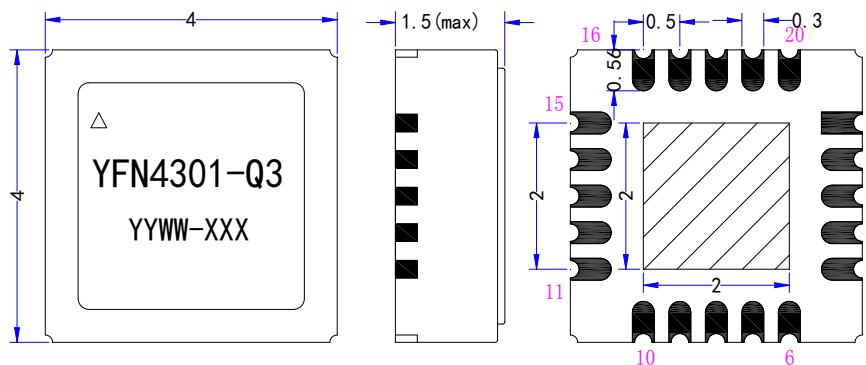
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$V_{CC}=+5.0V$ $Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$ $f=100\sim 500MHz$	100		500	MHz	
功率增益	G_P		24	25	26	dB	
增益平坦度	ΔG_P				1	dB	
输入驻波比	VSWR _i			1.5:1	2.0:1		
输出驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		
噪声系数	NF			0.8	1.2	dB	
输出-1dB 压缩点	P _{-1dB}		11.5	13.5		dBm	
反向隔离度	ISO		30	35		dB	
工作电压	V_{CC}		+4.75	+5	+5.25	V	
电源电流	I_{CC}	$V_{CC}=+5.0V$, $P_{in}\leq -20dBm$		75	85	mA	
质量	m				2	g	

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+5.5	V	输入射频功率	18.0	dBm
贮存温度	-55~+125	℃			

封装外形图：

单位：mm 公差：±0.2mm



注：本产品为金属陶瓷封装

字符标志：

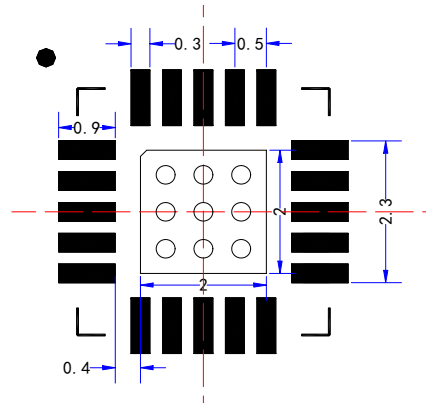
YFN4301-Q3	产品型号
Δ	1 脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

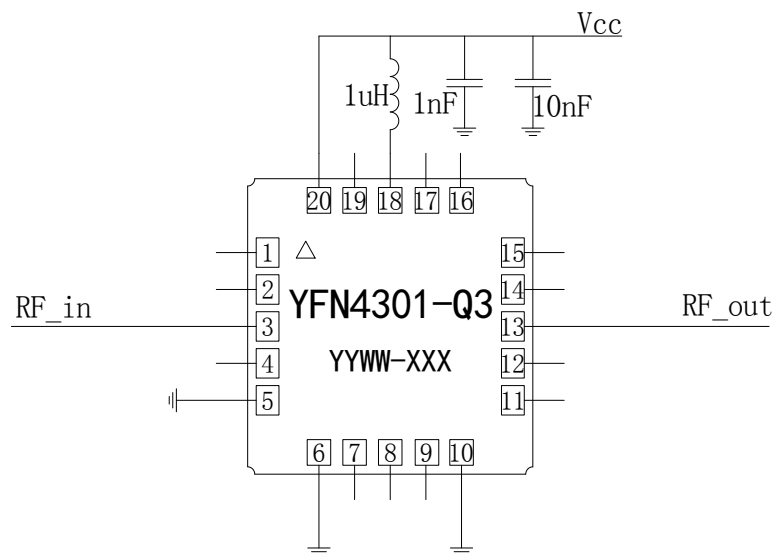
引脚	定义	备注
3	RF IN	射频输入端
13	RF OUT	射频输出端
18/20	V _{CC}	电源端口
5/6/10/底部焊盘	GND	接地端
其他	NC	悬空

推荐焊盘图：

单位： mm 公差：±0.2mm

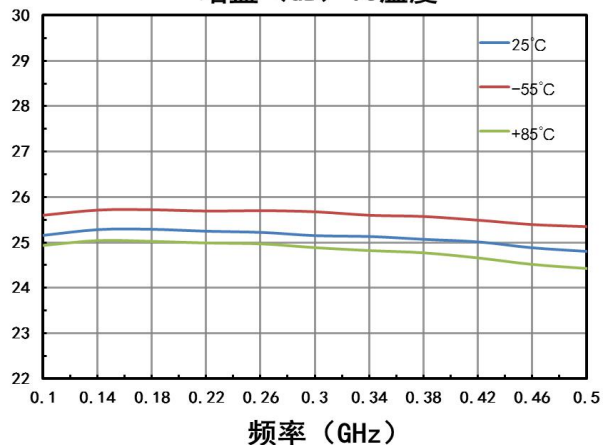


推荐装配电路：

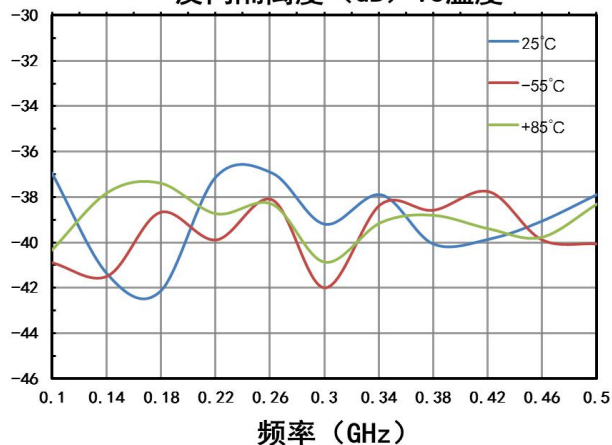


典型测试曲线：

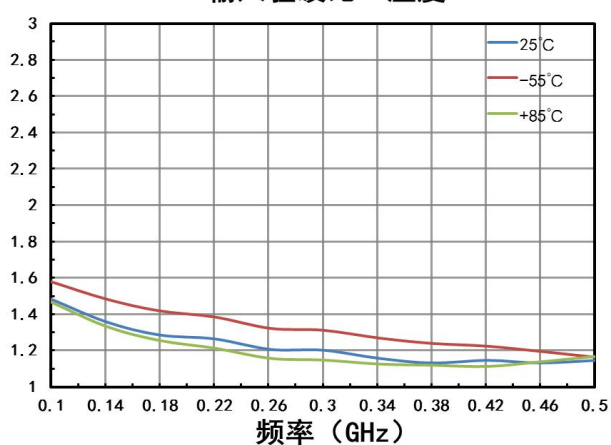
增益 (dB) VS温度



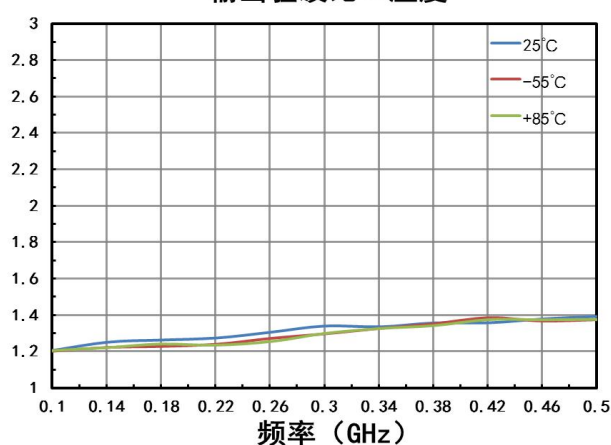
反向隔离度 (dB) VS温度



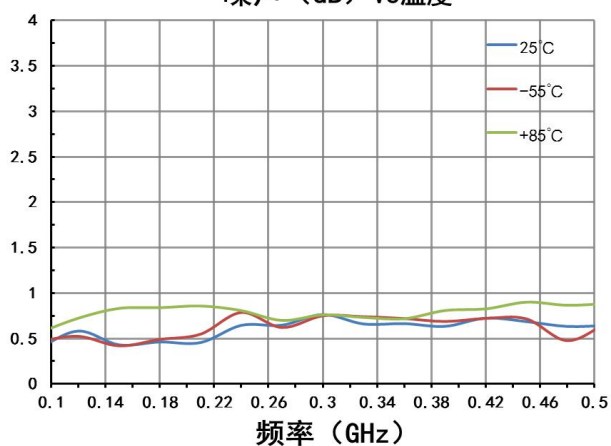
输入驻波比VS温度



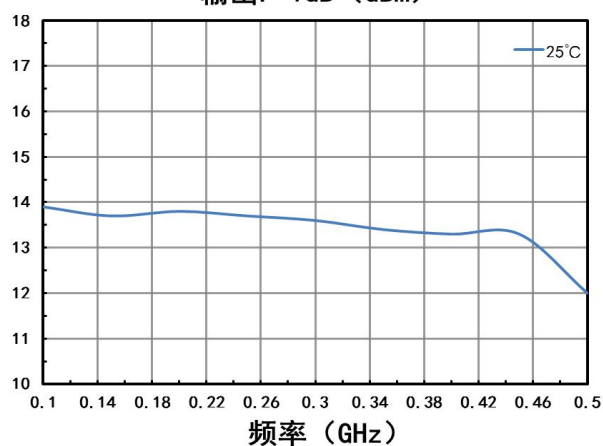
输出驻波比VS温度



噪声 (dB) VS温度

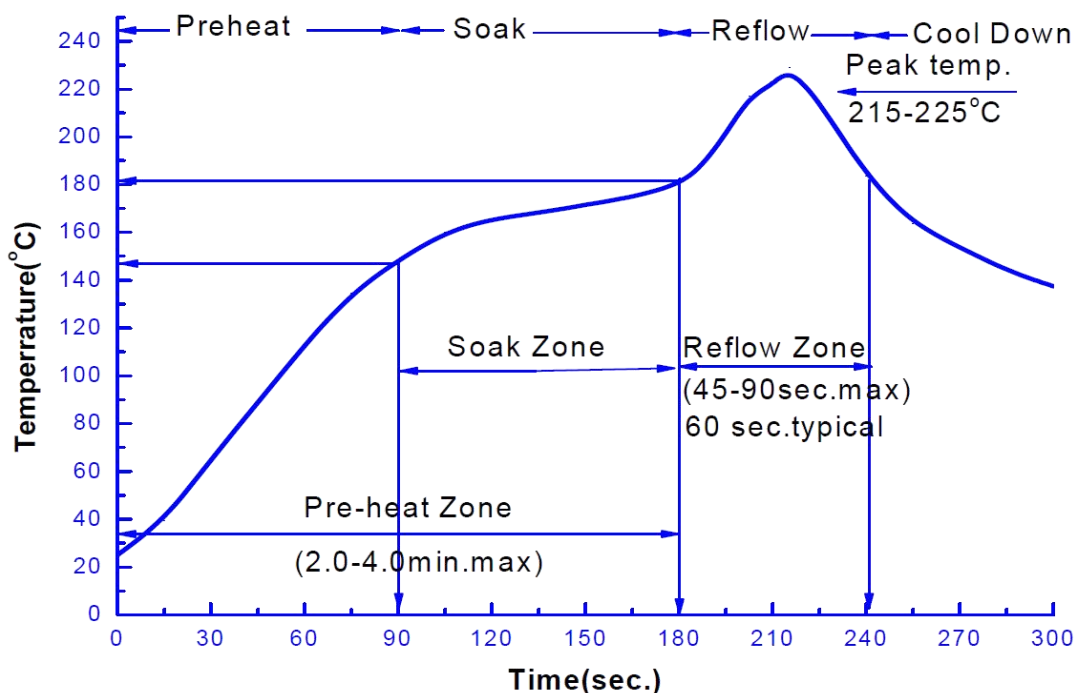


输出P-1dB (dBm)



产品使用注意事项：

- 1.产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。